

2009年3月期 第1四半期 事業説明会

(2008年8月5日実施)

スライドP1 ～ 代表取締役社長 川村誠

スライドP11～ 取締役執行役員専務

 フインセラミック事業本部長 兼 半導体部品事業本部長 久芳徹夫

スライドP25～ 京セラミタ株式会社 代表取締役社長 駒口克己

代表取締役社長 川村誠スピーチ

<スライド：本日のプレゼンテーション>

本日は、私より2009年3月期第1四半期の決算概況と、第2四半期以降の各事業の取組みについてご説明申し上げます。

私の説明の後、半導体部品事業と情報機器事業について、それぞれ担当しております久芳と駒口より、今後の取組みにつきましてご説明申し上げます。

<スライド1：将来予想に関する注意事項>

なお、本日の説明内容につきましては、こちらの「将来予想に関する注意事項」にご留意願います。

<スライド2：2009年3月期 第1四半期 連結業績>

こちらのスライドは7月30日に公表いたしました、当期第1四半期の連結業績です。

第1四半期の売上高は、三洋電機株式会社の携帯電話端末事業等を承継したことや、ソーラーエネルギー事業の売上が大幅に伸びたことなどにより、前年同期に比べ5.2%の増収となりました。

一方、表の上から3段目にあります税引前四半期純利益は、米ドルに対する円高進行の影響や減価償却費の増加などにより、8.8%の減益となりました。

表の中ほどにあります設備投資額ですが、第1四半期の実績は180億円となり、前年同期に比べて19.4%の増加となりました。通信機器関連事業での増加やソーラーエネルギー事業での生産能力増強によるものです。

また、減価償却費は前年同期に比べ18.2%増加の193億円となりました。

<スライド3：2009年3月期 第1四半期 セグメント別売上高・税引前四半期純利益>

こちらのスライドは、売上高及び税引前四半期純利益を前年同期と比較し、事業セグメント別に増減金額を示したものです。

まず上段の売上高ですが、先程申しあげましたとおり、通信機器関連事業やソーラーエネルギー事業の貢献に加えて、半導体部品関連事業において、セラミックパッケージを中心に需要が堅調に推移したことにより、前年同期と比べ163億円の増収となりました。

一方、下段の税引前四半期純利益は、ファインセラミック応用品関連事業や半導体部品関連事業、通信機器関連事業が増益となったものの、アジアを中心とする携帯電話端末向け電子部品需要の低迷や単価下落により、電子デバイス関連事業の利益が減少したことに加え、景気減速の影響により、情報機器関連事業の米国向け売上が減少したことを主因に、グループ全体では前年同期に比べ36億円の減益となりました。

以上が第1四半期の業績説明でございます。

続きまして、今期通期の業績予想についてご説明申し上げます。

<スライド4：2009年3月期 事業環境見通し>

まず、事業環境見通しについてご説明申し上げます。

こちらのスライドに、2008年暦年の主要電子機器の生産台数見通しを示しております。この見通しについては、本年4月の期初予想から変更はありません。第2四半期以降、クリスマス商戦に向けてデジタルコンシューマ機器の需要が拡大するものと考えており、いずれも前年比で2桁の数量増を予想しております。これに伴い、第2四半期以降、部品需要も緩やかに回復してくるものと考えております。

しかし、部品単価の動向につきましては、セラミックコンデンサを例にとりますと、期初予想では年間で前期比10～15%の価格下落を想定しておりましたが、足元の状況を踏まえ、前期比15%前後の下落率になるものと予想しております。

<スライド5：2009年3月期 連結業績予想>

こちらのスライドは、4月に公表いたしました通期業績予想数値です。第1四半期の連結業績はグループ全体で計画通りに推移しており、通期業績予想については変更はありません。なお、最下段の表にあります平均為替レートにつきましては、ユーロの前提レートのみ変更いたしました。4月時点では対ユーロ152円を想定しておりましたが、第1四半期の実績を踏まえ、155円へと変更いたしました。

それでは、この通期業績予想達成に向けた第2四半期以降の具体的な取組みにつきまして、セグメント別にご説明いたします。

<スライド6：2009年3月期 第2四半期以降の見通し及び取組み（1）>

まず、「ファインセラミック部品関連事業」ですが、半導体製造装置用部品につきましては、需要回復の見通しは、依然として不透明であります。当製品については、足元の受注動向に動きはなく、今期は厳しい市場環境が続くと予想しております。しかしながら、携帯電話端末やPCのバックライトに使用されるLED用の単結晶サファ

イア基板の需要は堅調に推移しており、増産による売上拡大を図るとともに、グロープラグ用ヒーターコアをはじめとした、自動車部品の拡販に取り組んでまいります。

続きまして「半導体部品関連事業」ですが、第1四半期に引き続き、携帯電話端末やデジタル家電、サーバー関連向けに、セラミックパッケージ及び有機パッケージの売上拡大を図ってまいります。具体的な今後の取組みにつきましては、のちほど久芳よりご説明させていただきます。

<スライド7：2009年3月期 第2四半期以降の見通し及び取組み（2）>

続きまして、「ファインセラミック応用品関連事業」についてご説明申し上げます。

このセグメントの主な事業であるソーラーエネルギー事業は、欧州での需要が引き続き旺盛であり、これらの需要に応えるべく、生産量の拡大に努めています。原料調達量の増大により、当期第1四半期は前年同期比で約50%、前四半期比で約10%の生産拡大を果たすことができました。今期、年間300MWの生産を目指し、第2四半期以降も引き続き生産能力拡大を進めてまいります。当社は、既に、多結晶シリコン型太陽電池セルの量産ベースで世界最高の変換効率16.5%を達成しておりますが、この技術をさらに高め、来期から18.5%の変換効率を実現したバックコンタクトセルの本格量産の開始に向けて、今後、生産体制の構築に努めてまいります。これらの取組みにより、まずは早急に売上高1,000億円の達成を目指してまいります。

続いて、「電子デバイス関連事業」ですが、水晶関連デバイスについては、第2四半期以降、GPS機能を搭載した携帯電話端末やカーナビ関連、デジタル家電向けにTCXOや水晶振動子などのさらなる売上拡大を目指してまいります。

一方、セラミックコンデンサにつきましては、アジア地域を中心とした需給環境の低迷が懸念されますが、携帯電話端末やデジタルカメラ向けに、小型・高容量コンデンサなどの新製品の投入による需要喚起に加え、生産体制の合理化など、生産性の向上

に向けた取組みを行い、収益改善に努めてまいります。

<スライド8：2009年3月期 第2四半期以降の見通し及び取組み（3）>

次に、機器事業についてご説明申し上げます。

まず、「通信機器関連事業」ですが、国内市場では割賦販売等の影響により、買い替え需要の鈍化が懸念されております。また、海外市場においては、グローバル端末メーカーとの価格競争や客先によるインフラ投資の遅延などの影響が懸念され、厳しい事業環境が続くと予想しております。当社としましては、まずは承継事業との本格的なシナジー追求に向けて、より強固な事業基盤の構築を進めるとともに、具体的な中長期の事業戦略の策定に努めてまいります。

また、製品開発については、両社の商品開発における技術ノウハウを共有し、顧客ニーズにマッチした携帯電話端末の開発に注力してまいります。来年には、共同開発の成果としての新端末を投入したいと考えております。また、部材調達に関しましては、第1四半期から共同購買を一部開始しておりますが、第2四半期以降、本格的にスケールメリットを活かし、製造コストの低減を図ってまいります。

さらに、通信システム機器事業につきましては、来期の国内新サービス開始に向けて、次世代PHS基地局の開発と生産体制の準備を進めるとともに、WiMAX事業については、今期後半より基地局の開発に着手してまいります。

最後に「情報機器関連事業」です。米国景気の回復には時間を要するものと考えており、加えて価格競争の激化などが懸念されます。今期は下半期を中心に20モデルの新製品投入を予定しており、カラー製品の拡販に努め、収益拡大に取り組んでまいります。なお、当事業の今後の取組みにつきましては、のちほど駒口よりご説明いたします。

<スライド9：重点市場での事業拡大を推進>

ただ今ご説明申しあげました取組みを確実に実行し、今期業績予想の達成を目指してまいります。京セラグループは、こちらのスライドにありますように、「通信」、「情報」、「環境・エネルギー」、「車載」といった今後の成長が見込まれる4つの重点市場において、部品事業から機器事業にわたる多様な製品を供給してまいります。

<スライド10：持続的な収益拡大を目指す>

この4つの重点市場において、グループのシナジー追求と新製品・新技術の開発により、「創造と成長」を図ってまいります。当社は、部品専門メーカーとの差別化を図るとともに、今後の高い成長が期待できる、環境エネルギー市場での強固な事業基盤を有する強みを最大限に活かし、グループの成長を目指してまいります。そして、部品事業と機器事業の持続的な収益拡大を図ることにより、EPSの向上につなげてまいりたいと考えております。

今後とも皆様のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

取締役執行役員専務 ファインセラミック事業本部長 兼 半導体部品事業本部長
久芳徹夫スピーチ

<スライド11：2009年3月期 第1四半期の実績>

初めに2009年3月期第1四半期の実績をご報告いたします。

当期、第1四半期の実績は、売上高411億6700万円、前年同期に対し16.7%増、税引前利益61億9800万円、前年同期に対し54.1%の増、税引前利益率は15.1%と大きく改善することができました。

この要因は、セラミックパッケージ関連では、水晶/SAW用パッケージ、及びCCD/CMOS用パッケージの売上が増加したことによります。また、有機パッケージ関連では、ASIC用パッケージの売上が伸びたことに加えまして、これまで注力してきた有機パッケージ事業が、前期の第3四半期より黒字化したことが税引前利益の増加に大きく貢献しております。

<スライド12：半導体部品事業 四半期売上高・税引前利益率の推移>

このグラフは2008年3月期第1四半期からの四半期毎の売上高と税引前利益率の推移を示したものです。青の棒グラフで売上高を、赤の折れ線グラフで税引前利益率を示しております。

売上は、前期下期からの好調さが、今期第1四半期も持続しております。

利益率は、有機事業が貢献し、前期第3四半期から改善しております。

<スライド13：市場用途別 売上構成比>

このグラフは、2008年3月期の半導体部品関連事業の市場用途別売上構成比を示したものです。青色は携帯電話端末関連を、紫色はデジタル家電関連を、緑色はサーバー関連市場を示しております。この3つの市場が、半導体部品事業の主力市場です。

これら3市場をさらに拡大することと、赤で示しております新市場の拡大を図ってまいります。

<スライド14：半導体部品事業を取り巻く市場環境>

次に、半導体部品事業を取り巻く市場環境についてご説明します。

ここに示しますグラフは、半導体部品事業、主要3市場での代表的な商品である携帯電話端末、デジタルカメラ、サーバーの市場動向を示しております。

携帯電話端末市場では、生産台数ベースの伸びは期初予想通り、10%程度と予測しております。

デジタルカメラに関しては、当初、19%の伸びを予想しておりましたが、直近の顧客情報では若干軟化しており、現状では10%程度の伸びを予測しております。

サーバー市場に関しては、期初の予定通り6%程度の堅調な伸びを示すと予測しております。

これらの市場は概ね良好で、我々の好調な業績を下支えしてくれるものと見ております。しかしながら、最新情報では、これら市場の伸びの低下の予想も出ており、慎重に対応してまいります。

<スライド15：半導体部品事業の取り組み>

次に、半導体部品事業の取り組みに関して、ご説明します。

主力市場での売上拡大では

1番目に、携帯電話端末市場

2番目に、デジタル家電市場

3番目に、サーバー関連市場を説明します。

新市場開拓では、車載、医療機器、環境関連商品への展開を説明します。

<スライド16：携帯電話端末市場での売上拡大>

主力市場1番目の携帯電話端末市場での売上拡大は、現状搭載商品数の拡大と新規搭載商品の拡大を図ってまいります。

現状搭載商品の拡大では、赤枠で示しております水晶／SAW用パッケージは、多機能化により搭載数が増えております。

オレンジ枠のCMOSイメージセンサーは、搭載率の上昇で増加しており、青枠で示します高周波通信モジュール用パッケージは、高機能化により搭載数が増加しております。これらのセラミックの商品に加えまして、緑枠のアプリケーションプロセッサ用有機SiP基板は、ICの高集積化に伴い、微細配線技術を用いたビルドアップ基板の採用が増えております。

水晶／SAW用パッケージと有機SiP基板に関しましては、後ほど詳細をご説明します。新規搭載商品では、キャパシタ用パッケージやマイク用パッケージの開発を進めております。今後も、新規アプリケーション開拓を積極的に行い、搭載品種の拡大を図ってまいります。

<スライド17：携帯電話端末市場での売上拡大ー水晶/SAW用パッケージの展開ー>

売上規模の大きい、水晶／SAW用パッケージの展開について説明いたします。

携帯機器は、小型／薄型化が進んでいきます。下に水晶用パッケージのトレンドを示しております。

小型化を行うためには、この写真に示しておりますようにパッケージの壁厚を薄くす

るところに大きな技術課題があります。その課題解決のためには、セラミック材料強度と信頼性確保が、大変重要となってきます。

京セラの強みは、高いマーケットシェアを生かして最先端のニーズを入手できることにあります。こうして得られたニーズに対応するための材料開発力、並びに、過去から培ってきた高信頼性確保のノウハウが、我々の強みとなっており、2016サイズを他社に先駆けて市場投入してきました。

今後もさらなる小型化に対して、継続的な最先端パッケージの開発を行い、事業拡大を図ってまいります。

＜スライド18：携帯電話端末市場での売上拡大ー有機SiP

（システムインパッケージ）基板の展開ー＞

次に、有機SiP基板の展開につきまして説明いたします。

市場ニーズは前述と同様に小型・薄型化と半導体の高密度実装化です。

左の図は、SiP基板の薄型、高密度化のトレンドを示しております。

パッケージの厚みは、0.3mmから、0.25mm、0.23mmと年々薄型化が進んでおります。加えて、高密度化のために、半導体の多段実装化が進んでおり、フリップチップ実装とワイヤーボンディングの併用が求められています。これらの要求に対しまして、京セラの強みである薄型基板の生産技術力と、2つの実装手法に対応する多彩な表面処理技術、これらと優れた微細配線技術を加えて、市場ニーズに対応しております。

これらの強みをさらに強化し、有機パッケージでも携帯電話市場に積極的に展開を図ってまいります。

＜スライド19：デジタル家電市場での売上拡大＞

次に、デジタル家電市場を説明いたします。

デジタル家電市場も、携帯電話市場と同様に軽薄短小が強く求められており、我々の強みを生かして、積極的に展開しております。

ここに示しましたのは、代表的なデジタル家電製品への我々の商品の展開例です。最近では、ゲーム機に搭載されるジャイロセンサ用パッケージといった新商品も拡大し

つつあり、これらを伸ばして、さらなる売上拡大を図ってまいります。

＜スライド20：サーバー関連市場での売上拡大－当社の強み－＞

続いて、サーバー関連市場での売上げ拡大についてご説明します。

この市場における当社の強みの1番目は、強固な顧客関係です。我々は、この市場のパイオニアとして、シリコンバレーの半導体産業勃興期からパッケージの供給を行っており、強固な顧客関係を構築しております。

その結果として、セラミックのみならず、有機パッケージでもマーケットシェアナンバーワンを獲得し、業界トップにあると自負しております。

強みの2番目は高性能パッケージ技術です。優れた電気特性設計技術、微細配線技術、多層化技術、そして、セラミック材料の開発力を持っており、他社にない高性能パッケージ技術を保有しております。

＜スライド21：サーバー関連市場での売上拡大－さらなる高性能化の追求－＞

これらの強みを活かして売上げ拡大を図るために、さらなる高性能化を追求してまいります。

市場ニーズである多ピン化、狭ピッチ化、高速伝送化に対しまして、セラミックパッケージ、有機パッケージともに、強みの維持によるマーケットリーダーのポジションを堅持してまいります。一例として、セラミックの材料特性を活かした展開があります。

近年、サーバー市場は、高速、大容量伝送に向かっております。しかしながら、LSIチップの微細化のスピードが追いつかず、チップの大型化が進んでおり、実装信頼性の確保が課題となってきております。セラミックは、シリコンに近い熱膨張係数が実現でき、かつ、優れた剛性をもっており、リフロー工程などの実装時の熱変形が小さいという強みを持っております。これらの強みを生かしてさらなる市場拡大を図ってまいります。

＜スライド22：新市場開拓：車載、医療機器、環境関連商品への展開＞

次に、新市場開拓の取り組みについてご説明します。

新市場開拓は車載、医療機器、環境関連商品向けに展開してまいります。

車載向けはECU基板、各種センサ用パッケージ、ミリ波レーダー用パッケージの展開を行っています。

医療機器向けは、CTスキャナー用基板、内視鏡用パッケージの展開を行っています。

環境関連商品に関しては、LED用パッケージがあります。

この中で、特に市場拡大しております車載向けに関して、次に詳細をご説明させていただきます。

＜スライド23：新市場開拓車載、医療機器、環境関連部品への展開

－車載セラミック基板・パッケージ展開－

車載市場におけるニーズは、環境・低燃費への対応、安全性の向上、快適・利便性の追求です。これらを実現するために、自動車のエレクトロニクス化が急激に加速しております。従来から市場展開しているECU基板は耐熱性が求められ、各種センサ用パッケージに求められる機能は、気密性と小型化です。これらの要求に対応できるのがセラミックパッケージです。今後も継続的に新たなアプリケーションの開発に取り組んでまいります。

＜スライド24：半導体部品事業の今後の展開＞

最後に、半導体部品事業の今後の展開についてご説明します。

京セラには、携帯電話や複写機を製造する機器部門や、水晶振動子を製造する電子部品部門、並びに自動車部品部門があります。これらの部門との連携を強化し、機器や部品のニーズを先取りすることにより、他社に先駆けた新商品開発を継続してまいります。

これら、京セラグループの総合力を活用し、積極的な事業展開を図り、さらなる事業拡大を目指してまいります。

＜スライド25：2009年3月期 第1四半期実績＞

京セラミタは京セラの機器事業の中で、主にプリンタやデジタル複合機などのドキュメント機器事業を担当しております。

それでは最初に2009年3月期、第1四半期の実績について、報告させていただきます。

連結売上高は611億14百万円となり前年同期比9.2%減少致しました。税引前利益は68億87百万円、前年同期比26.8%の減少となり、税引前利益率は11.3%となりました。

米国市場の景気減速によりオフィス機器への投資が減退してきている影響から、プリンタや複合機等の情報機器の需要が伸び悩んでおります。このような市場状況において価格競争が激化し、販売単価が下落しております。さらに、前年に比べUS\$に対して円高となったことから米国の売上は前年を下回りました。欧州と日本は厳しいながらも前年並みの売上実績となり、アジアは前年を少し下回る結果となりました。

利益面では市場競争による価格低下が大きく影響をしました。また、プラスチックや鉄材など、原材料の高騰もマイナス要因となりました。

＜スライド26：売上高・税引前利益率の推移＞

これは情報機器関連事業の2005年3月期以降の売上高と税引前利益率の推移を示しております。ご覧のように、これまで増収を続けており、2008年3月期には売上、利益ともに過去最高を達成しました。これまで、右肩上がりの成長をすることができたのは、欧州のプリンタの販売が堅調であったことと、プリンタ開発で培ったモノクロの長寿命化技術を導入した複合機が市場に受け入れられた結果であると考えております。現在はこの長寿命化技術をカラーモデルへ展開しております。情報機器の事業を伸ばしていくためには、機械の販売台数を伸ばし、市場の機械台数を増加させ、そこから上がる消耗品収益を増加させることが重要であります。今期、価格の下落がさらに進むと予測しておりますが、利益を圧迫することになっても販売台数を増加させることで、来期以降の収益の源泉を確保していきたいと考えております。

今期はプリンタの新製品を13モデル、複合機の新製品を7モデル開発し、合計20モデル

を市場投入してまいります。下期にはプリンタ、複合機共に市場競争力の高いニューエンジンのカラーモデルを計画しており、売上に貢献することが期待出来ます。大変厳しい市場環境にはありますが、これらの新製品投入の効果を活かし、今期売上目標の2,900億円の達成を目指してまいります。

<スライド27：情報機器関連事業の成長と拡大>

当社の2005年から2008年の4年間の年平均成長率は約5%となっています。これに対して、消耗品、パーツ、サービスの売上は年率11%の成長となっております。特にカラー消耗品は年率25%で成長しており、その成長率は益々加速しています。カラー消耗品の付加価値は非常に高いため、カラー消耗品の売上を拡大することで安定的な利益成長が期待できます。

<スライド28：企業顧客の統合管理ニーズの拡大>

当社の主要顧客セグメントである企業顧客において、プリンタ・複合機の管理の効率化、トータルコストの削減、文書のカラー化と電子化、セキュリティ、環境対応などの分野で課題があります。そして、最近はこれらの問題を解決するために、別々に管理されていたプリンタと複合機を統合して管理する傾向が見られるようになりました。我々は、この統合管理ニーズが新たなビジネスチャンスになると予想しております。当社では、プリンタと複合機を共通のプラットフォームで開発し、共通の販売チャンネルで提供する戦略をとってまいりました。この強みを活かして統合管理のシステム販売に現在取り組んでおります。

<スライド29：事業拡大に向けての取組み>

情報機器関連事業の拡大を目指す取組みとして、企業顧客の統合ニーズを満足させながら、カラー製品の設置台数を増やし、カラー消耗品の収益を最大化することが当社の戦略です。

そのために、①カラーエンジン・プラットフォームの開発、②コントローラ・プラットフォームの開発、③新カラートナーの開発とプラントへの設備投資、の施策を実施

しました。

続いて、それぞれの施策について説明させていただきます。

<スライド30：カラーエンジン・プラットフォームの開発>

京セラは“エコシス”コンセプトによりモノクロ製品での事業を伸ばしてきました。エコシスは、エコノミー、エコロジー、システムの造語です。当社のコアデバイスであるアモルファス・シリコンドラムを使って、独自の長寿命で信頼性の高いエンジンを開発したことで、ランニングコストの安いエンジンを作ることができました。そして、当社はトナー消費量の多い高ボリューム印字の顧客に受け入れられるブランドとなりました。カラー製品でも当社の顧客はランニングコストが安く、エコノミーな“エコシス”コンセプトを期待していましたので、カラー製品にてこのコンセプトを実現するために、当社は新たなエンジン・プラットフォームを開発しました。引き続きアモルファス・シリコンドラムを採用し、新たな現像方式にはハイブリッド型のシステムを採用しております。当社では、この現像システムをインタラクティブ・タッチダウン現像と呼んでおります。このカラー・エンジン・プラットフォームもモノクロの時と同様、プリンタと複合機の両方の製品に搭載してまいります。下半期には、第三世代となるカラー・エコシスプリンタと複合機を相次いで発売する予定です。

<スライド31：エンジン・プラットフォームの共有化>

プリンタと複合機のエンジン・プラットフォームを共有化する事は、“エコシス”コンセプトを生かした当社独自の開発戦略です。一般的に、プリンタはカートリッジタイプ、複合機は専門のサービスマンが保守サービスを行うことを前提としてエンジン構造が異なりますので、それぞれのエンジン・プラットフォーム開発には別々の技術資産を必要とします。

当社の場合、プリンタ用に開発されたエコシス・エンジン技術により、ほぼメンテナンスフリーの環境が出来ました。これは複合機にも共有可能な技術であることから、統一エンジン・プラットフォームでプリンタと複合機の両方を開発することが出来ます。これにより、限られたリソースの中で、プリンタと複合機のラインアップを供給

することが出来ています。

＜スライド32：コントローラ・プラットフォームの開発＞

当社はプリンタコントローラの自社開発を長年行っております。エンジンと同様に、この独自技術を複合機に応用し、複合機のスキャン機能やハードディスクを使用したソリューションの需要に対応してきました。その結果、自社プリンタとのコンパチビリティを保ちながら、ソリューション対応が可能な複合機用コントローラへと進化させてきました。これを当社ではワイズコアコントローラと呼んでいます。今後、需要が期待されるカラーの高速・高画質複合機に対応するために、今年、戦略的に米国ピアレス社のコントローラ技術資産の買収を行いました。このカラー処理技術を強化したワイズコアを、今期後半より、カラー複合機、カラープリンタに搭載することで、セキュリティ機能や管理機能を充実させてまいります。

＜スライド33：新カラートナー開発とプラントへの設備投資＞

新カラートナーの開発とプラントへの設備投資について説明いたします。カラートナーはこれまで開発を自社で行い、多くの生産を外部委託してきました。しかし、カラートナーへの要求品質が高まり、今後さらに需要増が見込まれるため、80億円の投資を行い、トナー開発のための化成品開発センターとカラートナー専用プラントを今年5月に稼働致しました。ここで新たに開発した小粒径、高画質トナーの生産を行い、今年後半に発売開始のカラー新製品に使用していきます。

＜スライド34：エンディング＞

これまで報告しました取組みを強力に進め、市場競争力の高いニューエンジンのカラープリンタや複合機を確実に市場投入し、大変厳しい市場環境にはありますが、今後の事業拡大に向けて今期の売上目標達成を目指してまいります。

以上